

# M-VIA Embedded<sup>®</sup> 部品内蔵基板

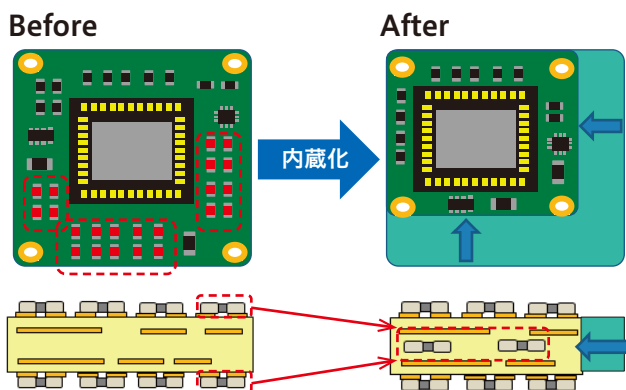
## Embedded Devices PWB

### 特長 Features

- ✓ 小型化、薄型化、搭載容量の増加  
Downsizing, Thinner, Increase of Mounting Capacity
- ✓ 配線長の短縮による低インダクタンス化、低ノイズ化  
Shortening the Path to Devices (Low Inductance, Low Noise)

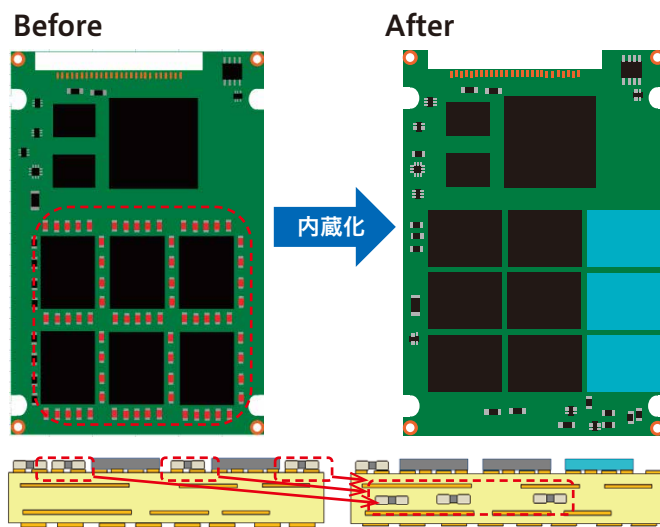
### 部品内蔵化による小型化

Downsizing by Embedding Chip Components



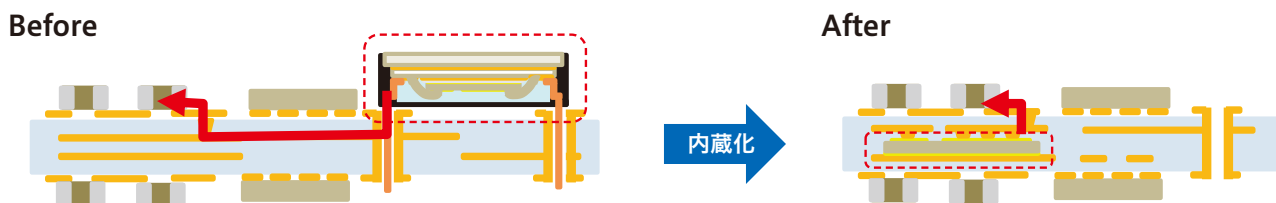
### 部品内蔵化による部品搭載容量の増加

Increase of Mounting Capacity by Embedding Chip Components

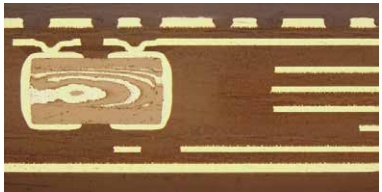




### 配線の短縮化による低インダクタンス、低ノイズ化

Low Inductance, Low Noise by Shortening the Path to Devices



### 基板構造 PWB Structure

パッシブ部品内蔵基板 Embedding Passive Components <span style="background-color: #ffff00;">量産中</span>	アクティブ部品内蔵基板 Embedding Active Components <span style="background-color: #ffff00;">R&amp;D</span>	パワー素子内蔵基板 Embedding Power Devices <span style="background-color: #ffff00;">R&amp;D</span>
めっき片面接続 Laser Attachment (Single-Sided)	めっき両面接続 Laser Attachment (Double-Sided)	厚銅めっき両面接続 Laser Attachment (Thick Cu Double-Sided Plating)
		
用途: カメラモジュール、 医療用モジュール、 通信モジュール、メモリードライブ等 Application: Camera Module, Medical Module, Communication Module, Memory Drive, etc	用途: バッテリーモジュール、 アンテナモジュール等 Application: Battery Module, Antenna Module, etc	用途: DCDCコンバータ、インバータ等 Application: DC-DC Converter, Inverter, etc